

2026-2029年臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫第三期-核定補助名單

編號	台方計畫主持人	台方執行機構	德方計畫主持人	德方執行機構	計畫名稱
1	李俊興 Chun-Hsing Li	國立臺灣大學 電機工程學系	Dietmar Kissinger	Ulm University	應用於通訊及感測融合之300-GHz可擴充式異質整合陣列 300-GHz Heterogeneously-Integrated Scalable Array for Joint Communication and Sensing Applications (TeraScale)
2	柯明道 Ming-Dou Ker	國立陽明交通大學 電子研究所	Heinrich Wolf	Fraunhofer Institute for Electronic Microsystems and Solid State Technologies EMFT	先進半導體製造場域靜電放電監控用之靜電放電事件偵測晶片設計與應用系 統建置 Taiwan-Germany Semiconductor Collaboration -- Chip Design and System Development for Monitoring Electrostatic Discharge during Advanced Integration Processes (CDMEDAIP)
3	阮聖彰 Shanq-Jang Ruan	國立臺灣科技大學 電子工程系	Hendrik Wöhrle	Fraunhofer IMS	STICAM -快取記憶安全 Transformer 系統 STICAM - Secure Transformers in Cache Memory
4	李宗恩 Tsung-En Lee	國立陽明交通大學 半導體工程學系	Jens Trommer	Namlab gGmbH	MERIDIAN: 先進製程單晶片整合新興技術之功能強化人工智慧加速器 Monolithically Integrated Emerging Technologies for Functionally Enhanced AI Accelerators in Advanced Nodes (MERIDIAN)
5	李明昌 Ming-Chang Lee	國立清華大學 光電工程研究所	Niels Quack	IMS CHIPS	高熱導鑽石中介層技術應用於高速電光晶片異質整合 Thermally Conductive Diamond Interposer for High-Speed Photonic-Electronic Heterogeneous Chiplet Integration (TEDISPEC)
6	江孟學 Meng-Hsueh Chiang	國立成功大學 電機工程學系	Klaus Hofmann	Technische Universität Darmstadt	以憶阻器實現適用於解決組合最佳化問題的易辛機 Memristor based Machine for rapidly solving optimization problems in the Ising form (MesMerIsing)
7	歐陽汎怡 Fan-Yi Ou Yang	國立清華大學 工程與系統科學系	Nobert Herfurth	Leibniz Institute for High Performance Microelectronics – IHP	BioBond-AL：應用於感測器整合之鋁金屬薄膜低溫奈米線接合技術研發 BioBond-AL: Low-Temperature NanoWired Bonding on Al Top-Metal for Sensor Integration
8	傅家相 Jia-Shiang Fu	國立中央大學 電機工程學系	Michael Peter	Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz Institute, HHI	應用於通感融合 6G 基站之氮化鎵高能效前端 GaN Energy-Efficient Frontends for ICAS 6G Basestations (GAIN-6G)

※計畫執行期間：2026/07/01至2029/06/30

※核定通知另以公文發送。